

第 3 8 回ソルダリング分科会プログラム

日時：平成16年10月29日（金） 10：30～17：00

場所：自動車会館 大会議室（東京都千代田区）

主題；鉛フリー化の実用動向と問題点

	時 間	題 目	講 演 者
平成16年	10:30 ~ 12:20	司会 鎌田 信雄 (株)村田製作所)	
		『最新WEEE・RoHS・ELV(含むUSA・国内)の動向と今後の対応』 (55分)	日本電子(株) 品質保証室 松浦 徹也
		『グリーン調達調査共通化協議会によるグリーン調達調査の共通化』 (55分)	(社)電子情報技術産業協会 (JEITA) 環境・安全部 田中 浩幸
16	12:20 ~ 13:20	昼 食 休 憩	
	13:20 ~ 13:30	分 科 会 議 事	
10月29日	13:30 ~ 15:25	司会 山口 敦史 (松下電器産業(株))	
		『リフロー/フロー混載実装におけるICリード接合部剥離防止条件に関する検討』 (40分)	三菱電機(株) 生産技術センター デバイス製造技術推進部 田邊 剛 , 村井 淳一 出田 吾朗 名古屋製作所 川上 豊 , 近藤 元康
		『はんだ槽の腐食症状とその対策』 (40分)	(株)タムラエフエーシステム 技術部 企画開発課 岡野 輝男, 飯島 正貴 吉田 俊一
		『Ni、Geを添加したSnAgCu系鉛フリーはんだの特徴』 (35分)	富士電機アドバンステクノロジー(株) 生産技術研究所 第一開発Gr 渡邊 裕彦
16	15:25 ~ 15:40	休 憩	
金曜日	15:40 ~ 17:00	司会 藤内 伸一 (株)サンミナSCIシステムズジャパン)	
		『Biフリー大気対応Sn-Znペーストの開発』 (40分)	(株)ニホンゲンマ 技術部 萩尾 浩一
		『Sn-Zn-Al鉛フリーはんだを用いた実装技術』 (40分)	富士通(株) テクノロジーセンター 実装技術統括センター コンポーネント実装技術部 本間 仁

()内時間は、質疑応答時間を含む

プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。